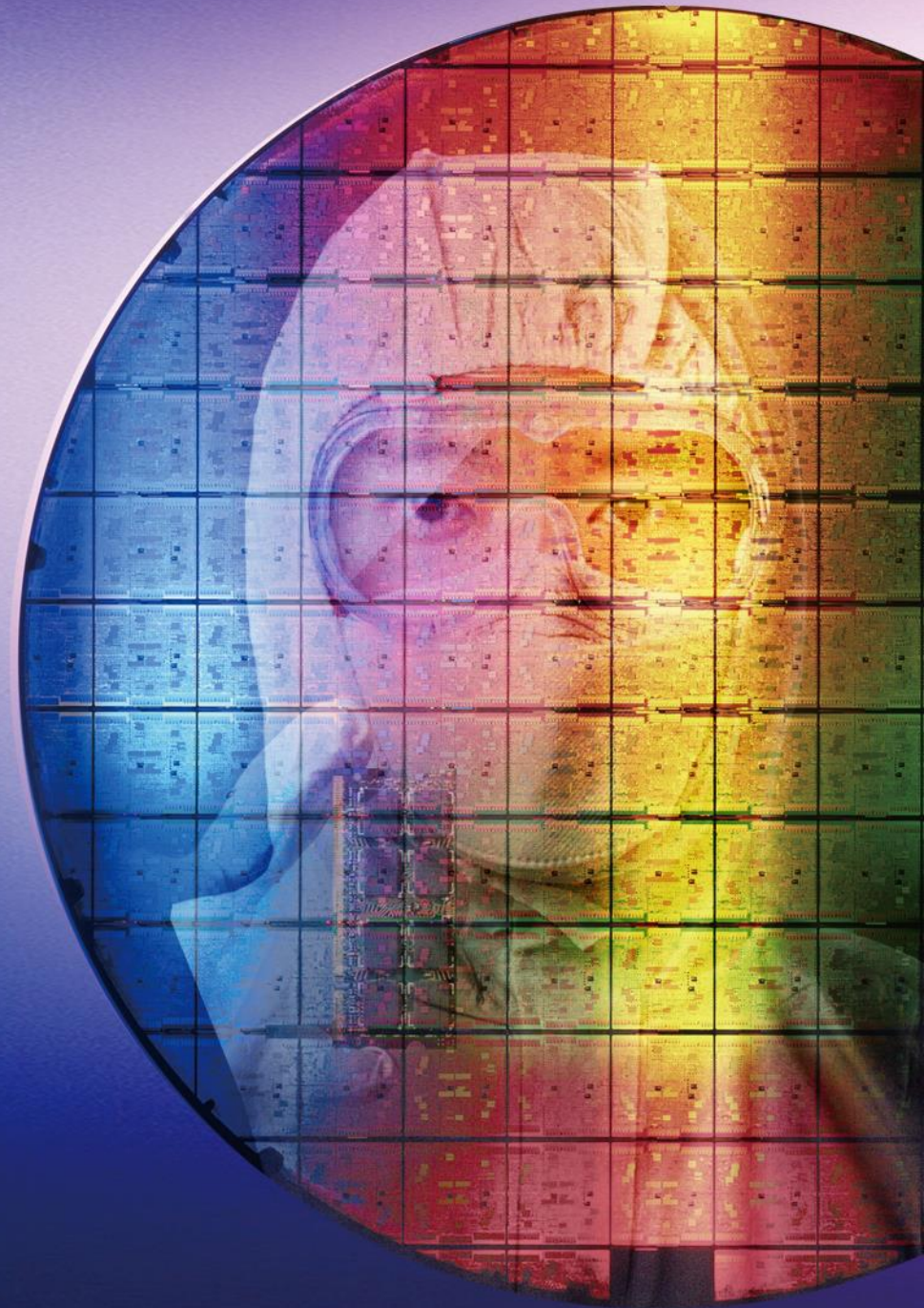




# Investor Relations

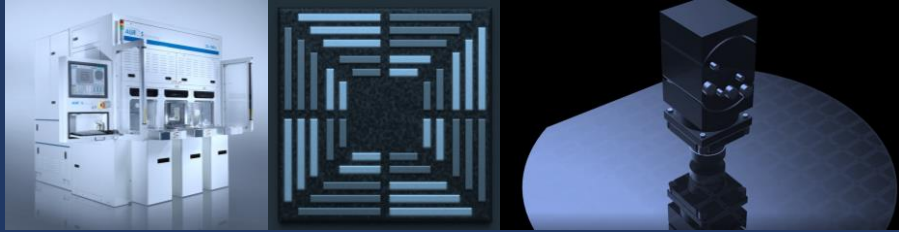
2025년 8월

AUROS Technology





# CONTENTS



TECHNOLOGY INNOVATION

오로스테크놀로지



1. 회사 개요 및 산업
2. 회사 연혁 및 실적
3. 조직도
4. Overlay (Front End)
5. 경영전략
6. R&D (Thinfilm & Back End)
7. R&D 성과 (Back End)

## Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보제공을 목적으로 (주)오로스테크놀로지(이하“회사”)에 의해 작성 되었으며이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준에 따라 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경 될 수 있으며, 개별의 고지 없이 변경될 수 있음을 양자하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 계열사, 자문역 또는 Representative들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함) 본 문서는 주식의 매매 및 투자를 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

# 1. 회사 개요 및 산업



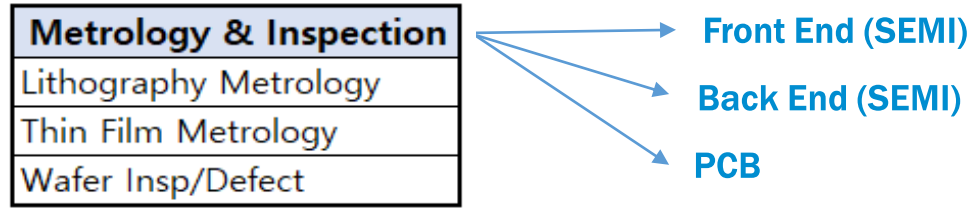
## 회사 개요

- 법인명 : (주)오로스테크놀로지
- 대표이사 : 이준우, 최성원
- 임직원수 : 국내 203명 / 해외 19명
- 업종 : 반도체 계측 및 검사 장비업 (Metrology & Inspection)
- 주요 제품 : Overlay (Front & Back End) 외
- 주요 개발 제품 : Thinfilm (Front) & Back End 외
- 홈페이지 : <http://www.aurostech.com>
- 본사 및 연구소 : 경기 화성시 동탄산단6길 15-23 (Overlay 외)
- 연구소2 : 경기 화성시 동탄첨단산업1로27 IX타워 A동 3층 (Thinfilm)
- 국내지점 : 이천(1), 청주(1), 평택(1)
- 해외법인 및 지점 : 미국법인(1), 중국법인(2) 및 일본지점(1)
- 최대주주 : FST(33.5%)

## 주요 임직원 현황

| 성명  | 직책          | 주요경력                                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|
| 이준우 | CEO         | 부산대물리학과                                       |
|     |             | 나노메트릭스코리아(주) 기술연구소 수석연구원                      |
|     |             | (주)오로스테크놀로지 대표이사                              |
| 최성원 | CEO         | University of California, Los Angeles 기계공학 박사 |
|     |             | 삼성전자 반도체 연구소, 수석연구원                           |
|     |             | 세계최초 EUV AP 양산 Project 총괄리더                   |
|     |             | (주)에프에스티 부사장                                  |
|     |             | (주)오로스테크놀로지 대표이사                              |
| 최용근 | 고문          | 고려대학교물리학과                                     |
|     |             | (주)SK하이닉스 제조공정그룹 상무                           |
|     |             | (주)에프에스티 부사장                                  |
|     |             | (주)오로스테크놀로지 고문                                |
| 유재만 | CFO         | 경희대학교 MBA                                     |
|     |             | (주)에프에스티 재무부문 이사                              |
|     |             | (주)오로스테크놀로지 전무이사                              |
| 신장호 | IR<br>(발표자) | 아주대경영대학원 경영학과 회계학                             |
|     |             | (주)LS그룹, (주)원익그룹 재경팀                          |
|     |             | (주)오로스테크놀로지 IR팀장                              |

## MI Industry Summary

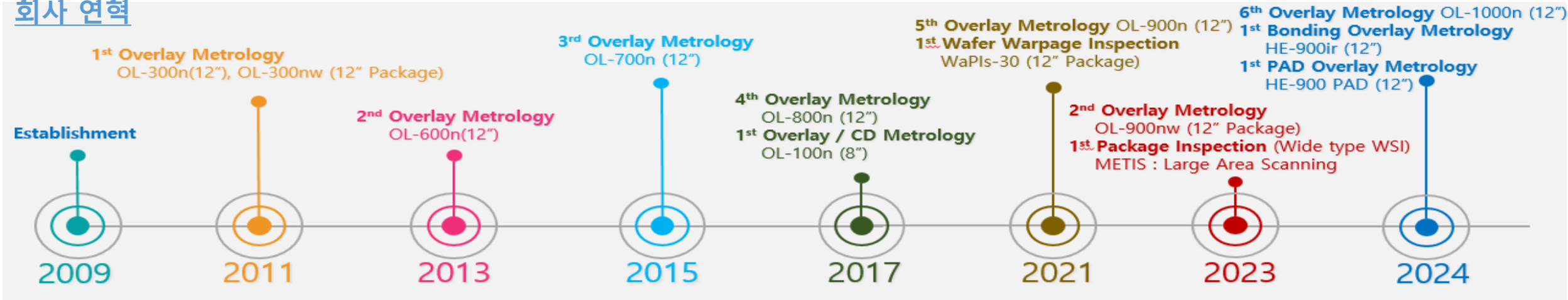


## Global MI 전문 기업을 위한 개요 및 산업 Summary

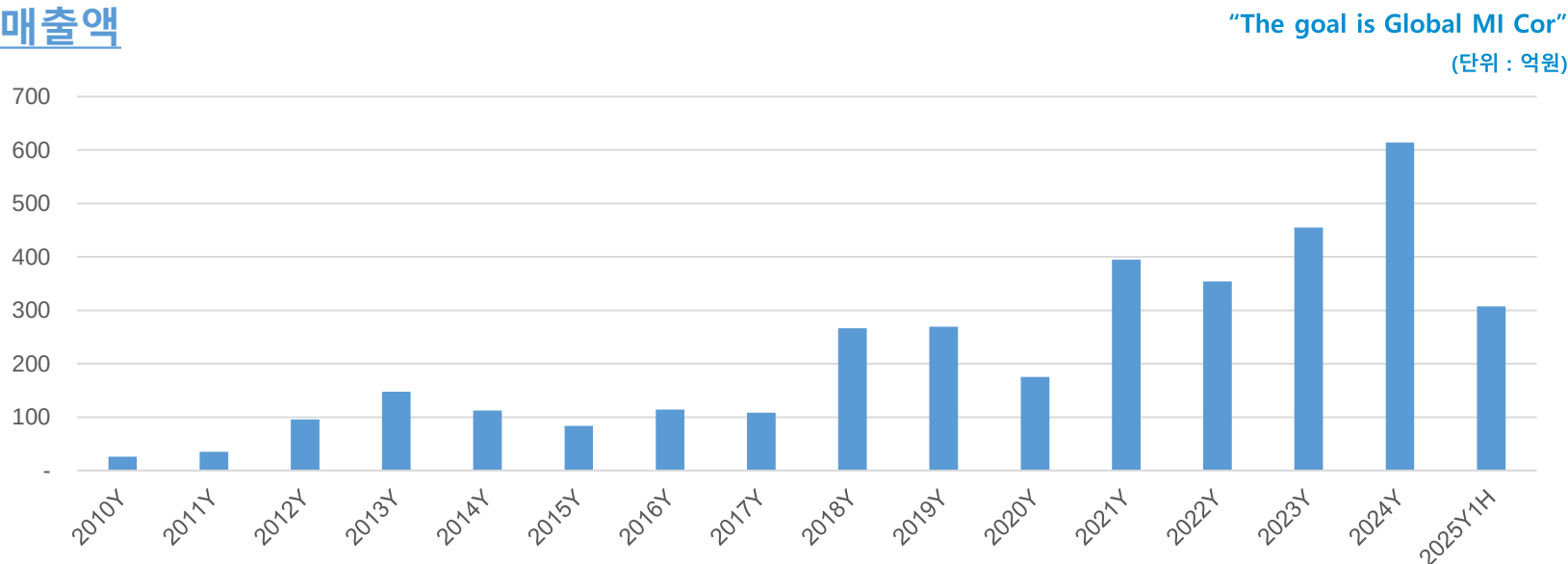
## 2. 회사 연혁 및 실적



### 회사 연혁



### 매출액

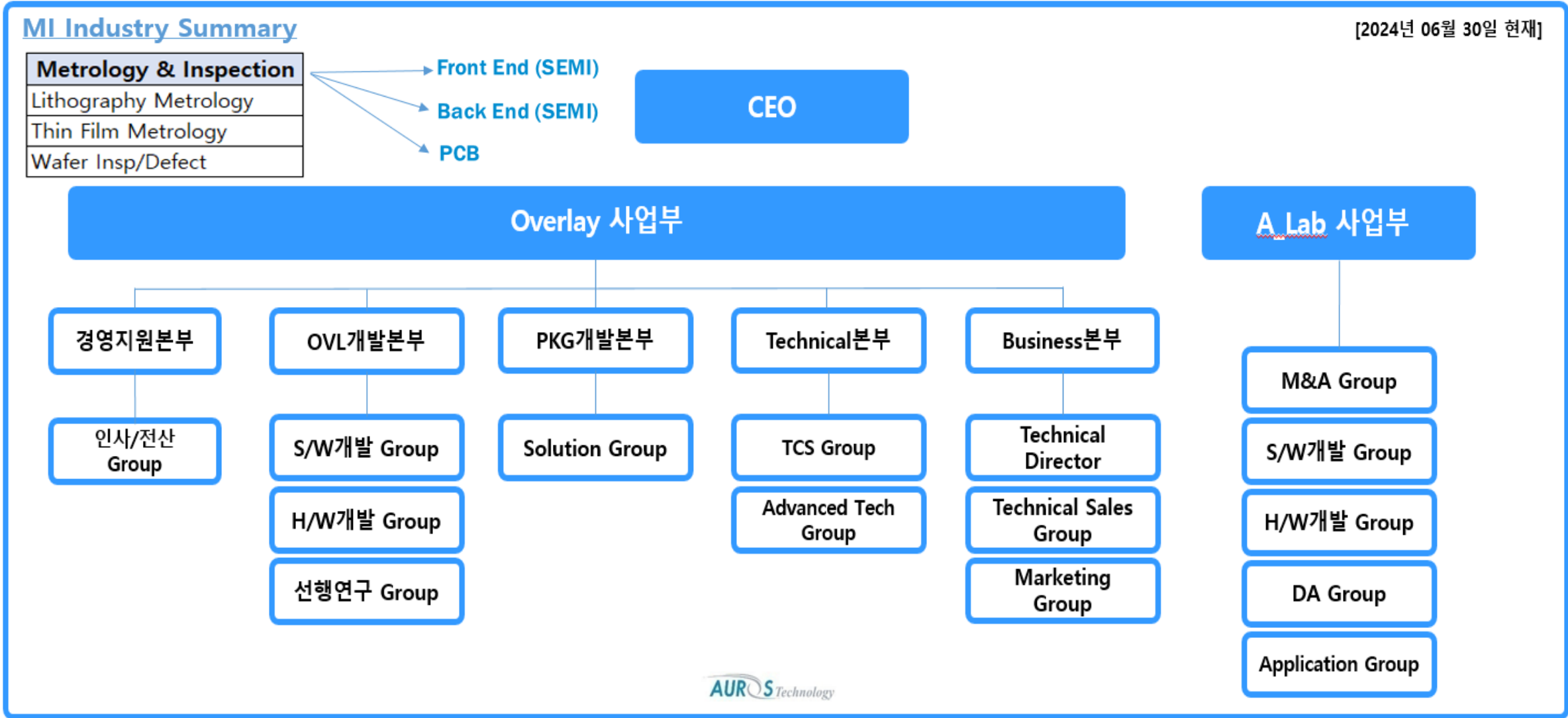


“MI는 압도적 고부가가치 산업”

| Symbol | Revenue TTM | Profit Margin | EBIT Margin | EBITDA Margin | FCF Margin | Return on Equity |
|--------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------------|
| ASML   | 27.26B      | 51.44%        | 30.66%      | 33.59%        | 0.29%      | 48.57%           |
| AMAT   | 26.50B      | 47.18%        | 28.87%      | 30.58%        | 17.28%     | 45.19%           |
| LRCX   | 14.91B      | 47.61%        | 29.02%      | 31.43%        | 23.48%     | 45.71%           |
| TOELF  | 12.39B      | 46.74%        | 27.06%      | 29.82%        | 14.30%     | 25.71%           |
| KLAC   | 9.81B       | 59.97%        | 37.03%      | 41.12%        | 22.22%     | 87.85%           |
| ATEYY  | 3.26B       | 51.91%        | 18.83%      | 24.02%        | 5.03%      | 18.31%           |
| ASMIY  | 2.79B       | 49.53%        | 24.86%      | 29.10%        | 9.81%      | 17.12%           |
| TER    | 2.70B       | 57.06%        | 19.00%      | 23.23%        | 15.98%     | 19.19%           |
| DSCSY  | 2.09B       | 68.72%        | 40.98%      | 45.08%        | 22.77%     | 25.54%           |
| UCTT   | 1.87B       | 16.40%        | 2.94%       | 6.68%         | 3.42%      | -0.02%           |
| ASMVF  | 1.71B       | 39.51%        | 4.70%       | 8.36%         | 11.72%     | 2.58%            |
| ACLS   | 1.11B       | 44.63%        | 23.40%      | 24.19%        | 12.50%     | 28.52%           |
| KLIC   | 727.23M     | 38.08%        | -4.30%      | -0.44%        | 5.51%      | -5.39%           |
| ACMR   | 693.56M     | 49.53%        | 17.21%      | 18.48%        | -11.43%    | 11.75%           |
| BESY   | 621.79M     | 65.48%        | 34.25%      | 35.73%        | 16.70%     | 40.81%           |

Global MI 전문 기업을 위한 History & 산업군 Margin(고부가가치)

### 3. 조직도



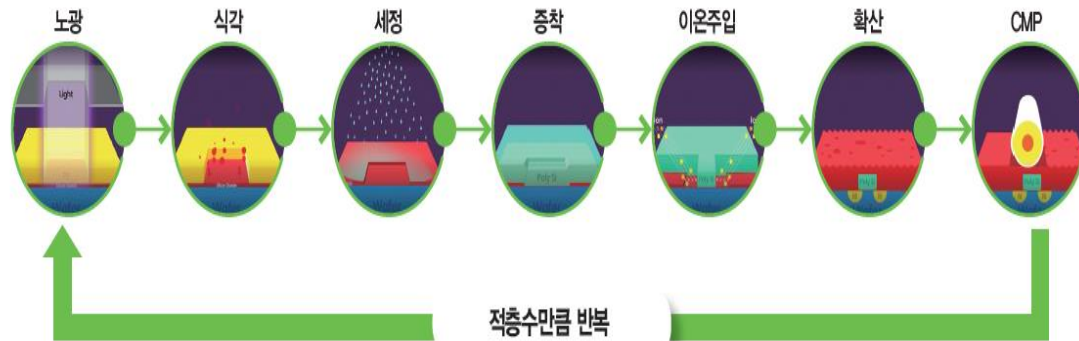
Global MI 전문 기업으로 거듭나기 위한 조직도



# 4. Overlay (Front End)

## 고난도의 노광 공정에 대한 모니터링과 제어

### 반도체 前공정 Process



### Overlay?

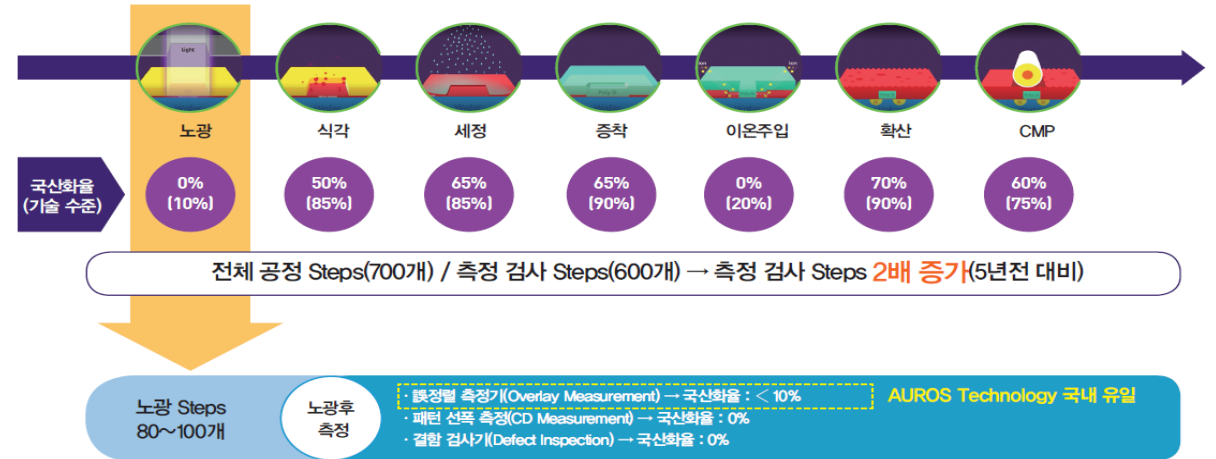
반도체 제조공정상 웨이퍼 표면에 여러 회로패턴들의 적층 시 회로 패턴간의 수직방향 정렬도(혹은 오정렬) 제어

- ① 수직적층 정렬도 측정 대상인 Overlay Target 측정
- ② 노광장비의 기계적 변화 및 옵틱변화에 제어 가능한 오류 모델링
- ③ 모델링 된 오류를 FA(Fab, Automation)를 통해 노광장비 보정
- ④ 필요시 재작업 지시

수율 개선에 직접적인 영향  
불필요한 제조 비용 투입 예방

## 높은 기술 장벽으로 인해 노광 공정 계속 국산화율 전무

### 반도체 前공정 국산화율



### Stacks are higher

- High-aspect-ratio etch
- CD profile and uniformity, tilt, shift control

### Structures are more complex

- Time to solution
- Process coverage
- Loading effect

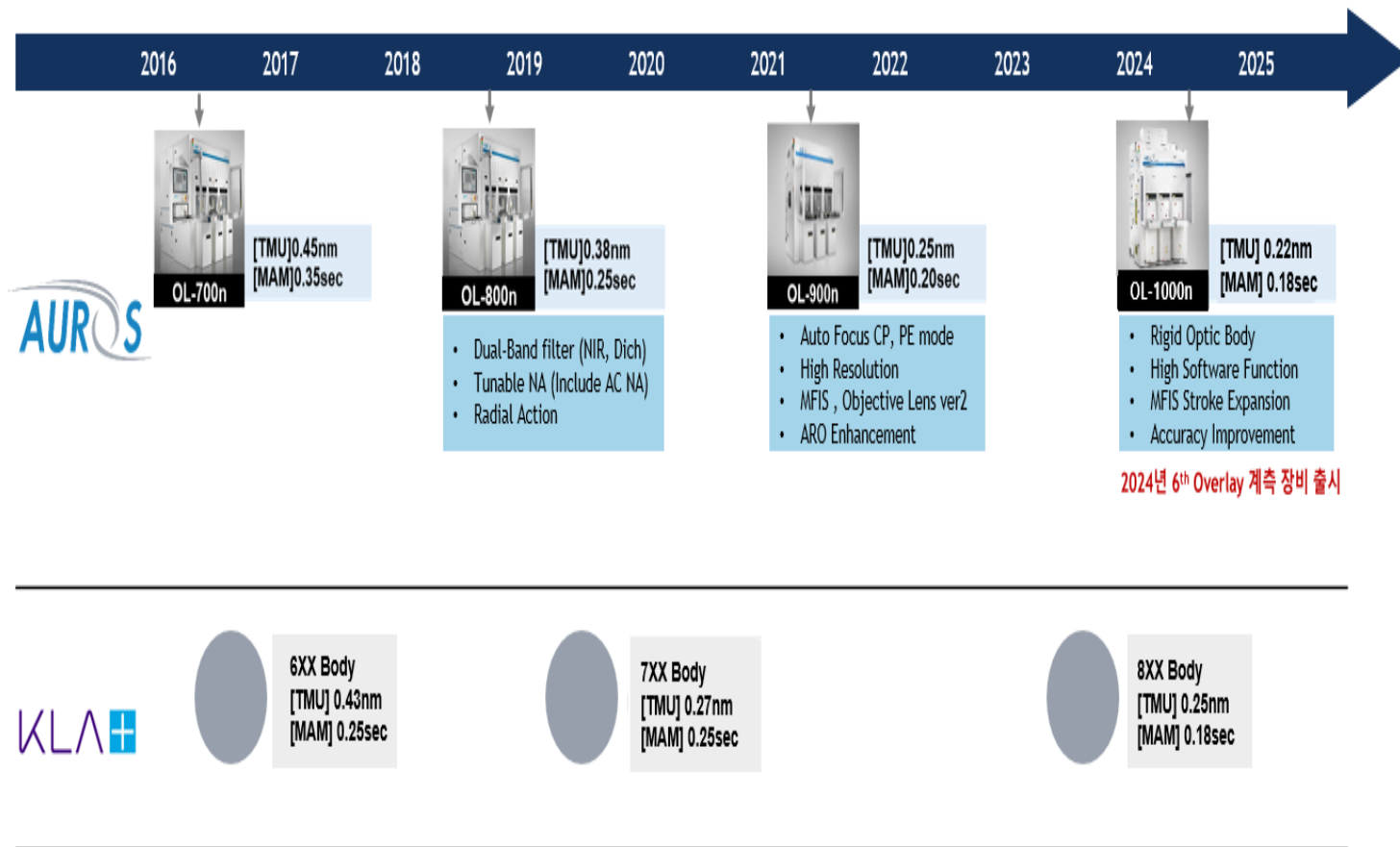
### Critical dimensions are smaller

- Error budget is tighter
- Local variation control
- Key parameters may be buried

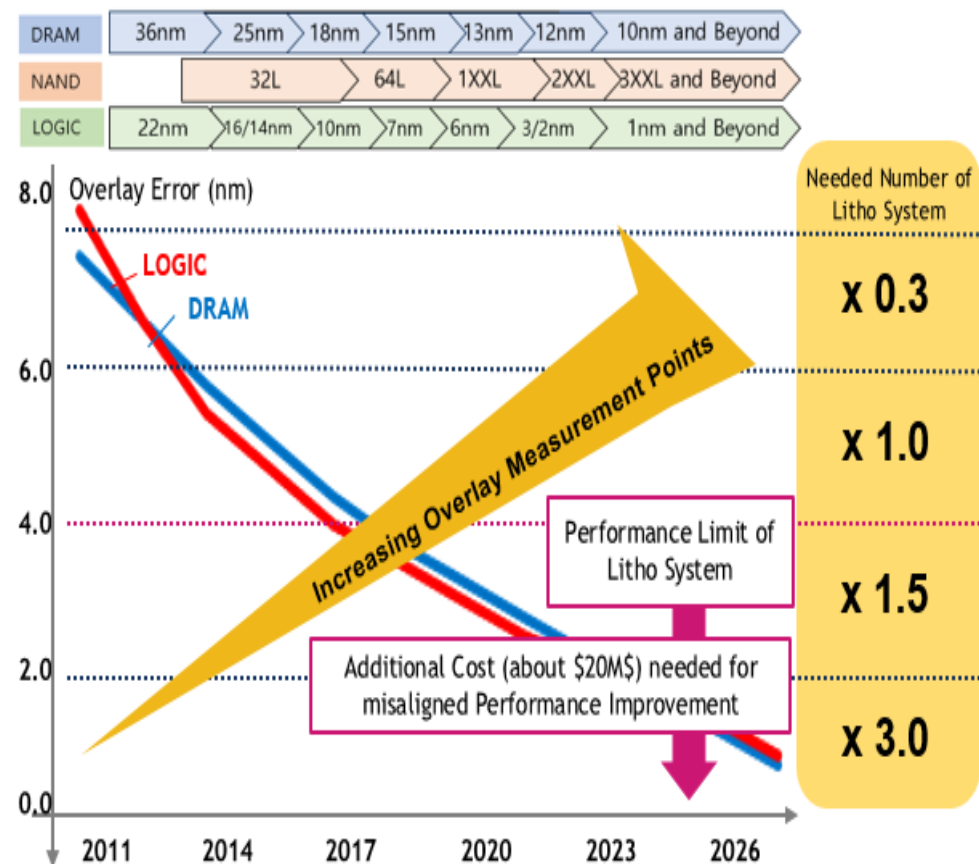
Global MI 전문 기업으로 거듭나기 위한 주력 Overlay

# 4. Overlay (Front End)

## 기술 발전에 맞춘 주기적인 신제품 출시를 통한 시장 선도



## 공정 미세화 및 신규 Fab 증설로 인한 장비 수요 증가



Global MI 전문 기업으로 거듭나기 위한 Overlay R&D 진행중

# 5. 경영 전략

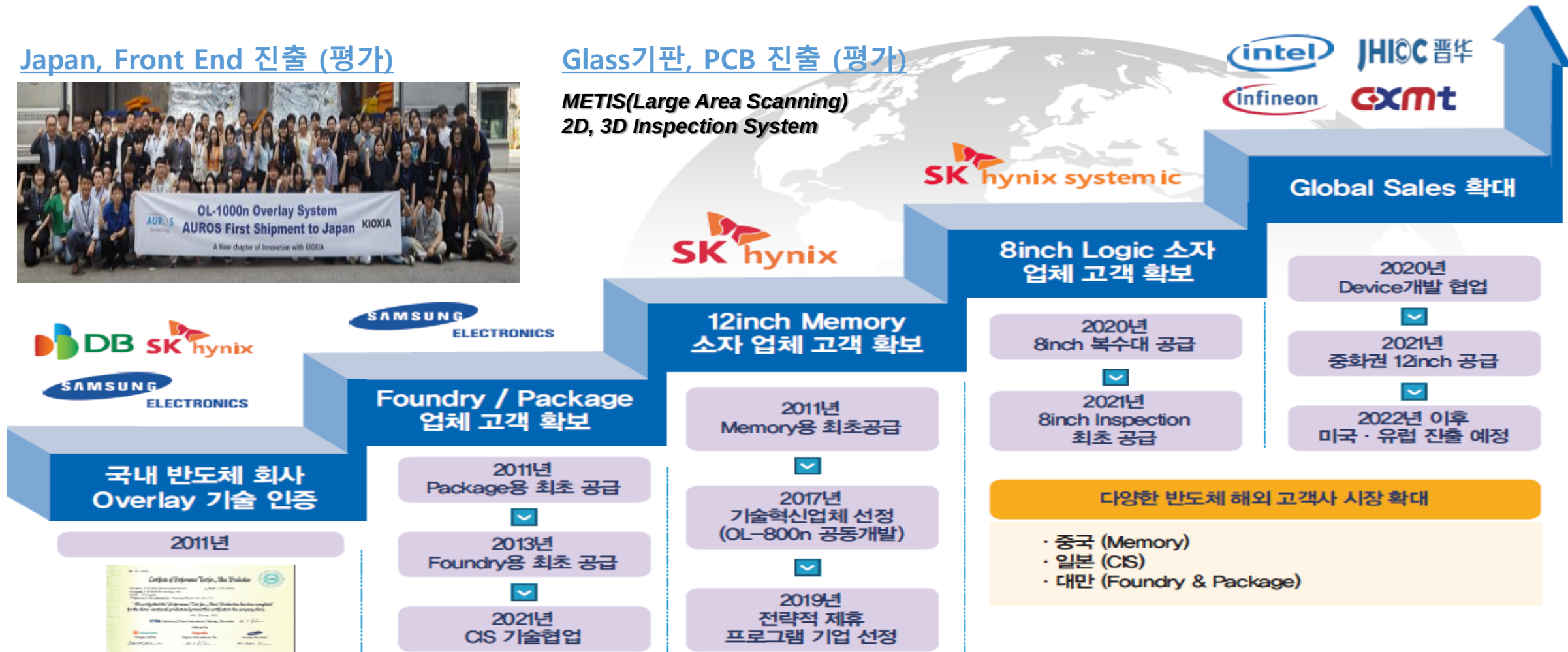
## 고객사와의 협력체계를 통한 제품 다변화 및 매출처 다각화

### Japan, Front End 진출 (평가)



### Glass기판, PCB 진출 (평가)

METIS(Large Area Scanning)  
2D, 3D Inspection System



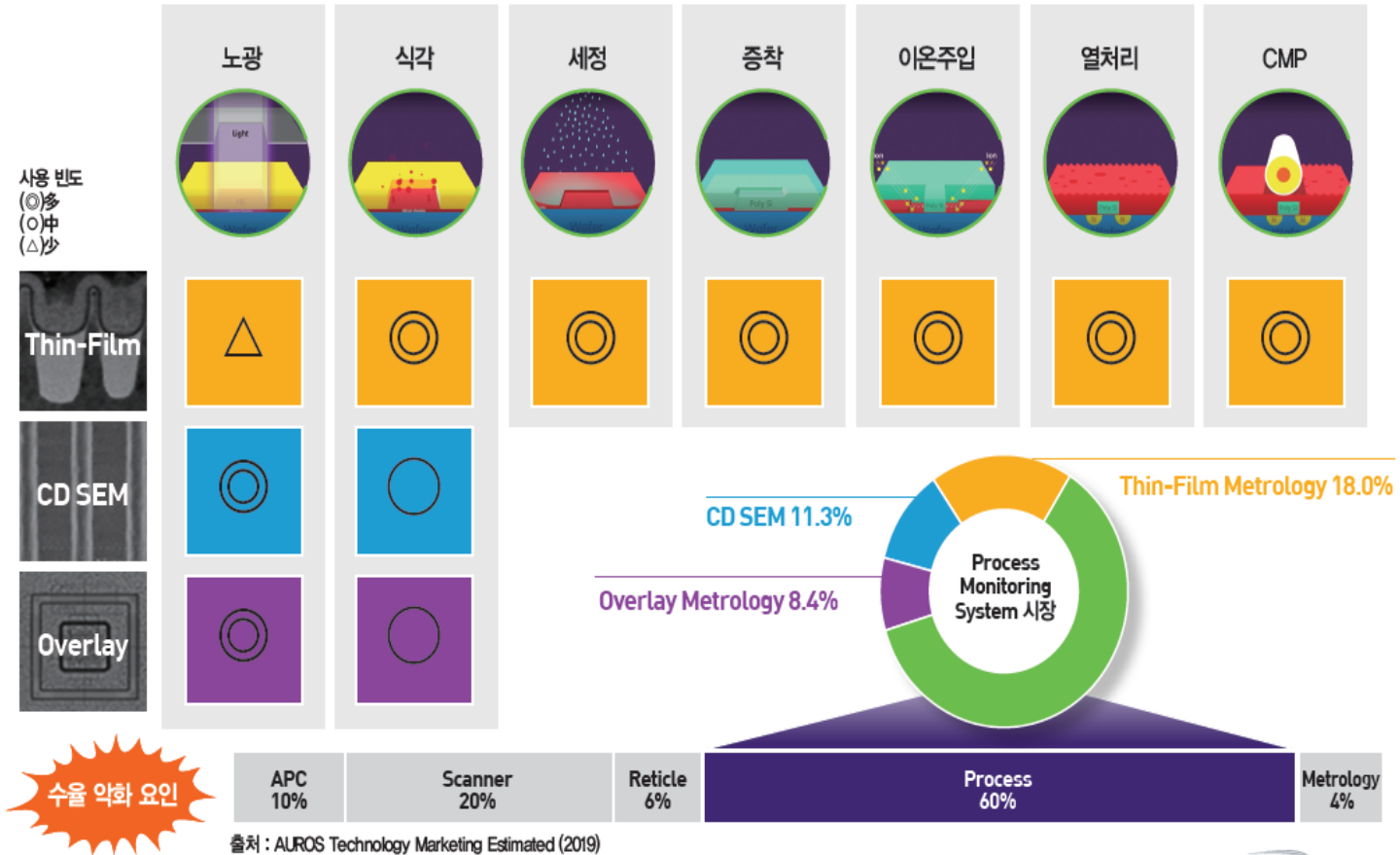
Global MI 전문 기업으로 거듭나기 위해 제품 및 고객사 다변화



# 6. R&D 진행중 (Thinfilm\_Front End)

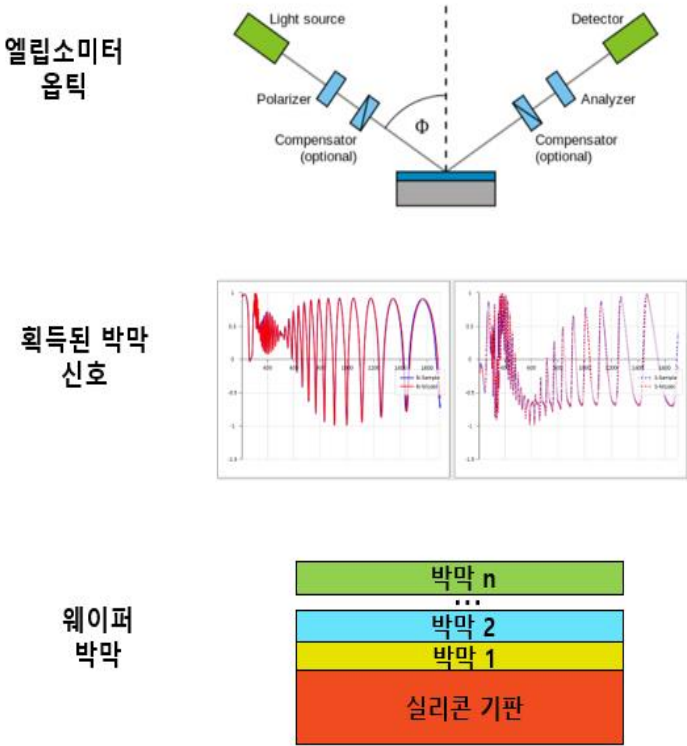
## 전공정 Metrology 업체로 거듭나기 위해 Thin-Film 계측 시장으로 진입

### 장비 별 공정 중요도



### 박막 두께 측정 시스템

엘립소미터 옵틱을 이용하여 박막(들)으로부터 반사된 편광 신호를 분석하여 단층 박막, 또는 다층 박막의 두께를 옹스트롬(Angstrom) 단위까지 수치적으로 측정하는 시스템



Global MI 전문 기업으로 거듭나기 위한 Front End MI 라인업 R&D 진행중

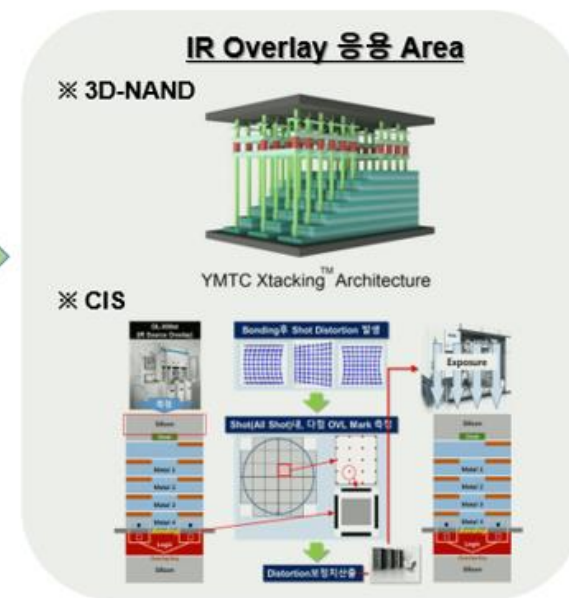
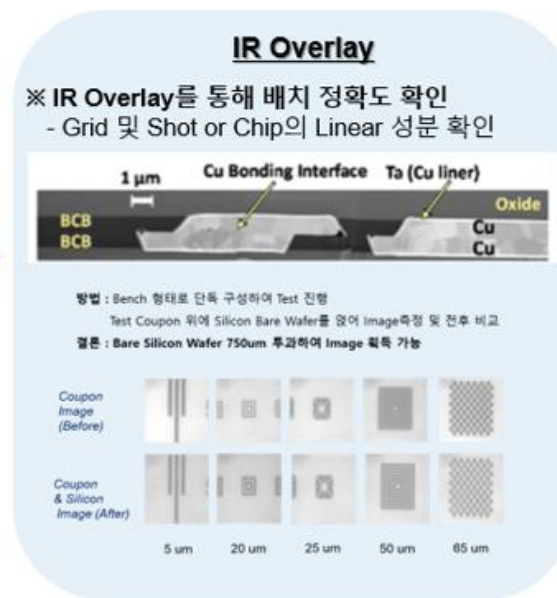
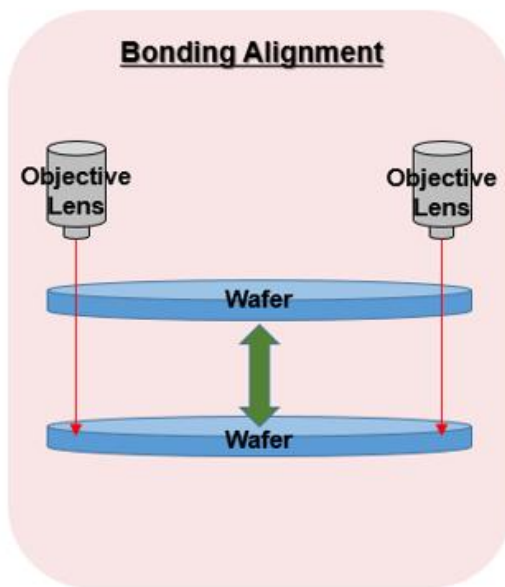
## 7. R&D 완료 후 고객 진입 (IR Overlay\_Back End)

### Hybrid Bonding 공정에서의 IR 오버레이 계측 장비 개발중

본딩용 Overlay 계측 장비 HE-900ir 고객사 First 업체로 진입 도전



IR Overlay 계측 장비  
HE-900ir



Global MI 전문 기업으로 거듭나기 위한 Advanced Packaging MI 라인업 R&D 진행중

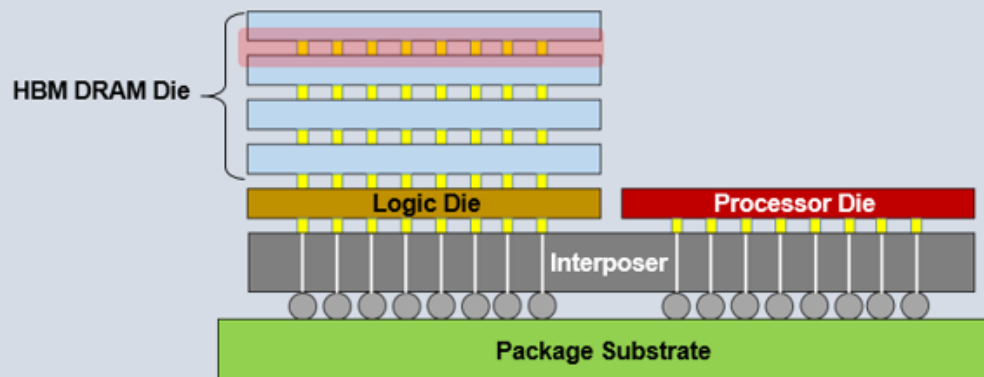
### HBM 공정에서의 PAD 오버레이 계측 장비 출시

오버레이 특화 기술 바탕 개발 출시 HE-900 PAD 고객사 복수대 장비 공급



PAD Overlay 계측 장비  
HE-900 PAD

HBM Stacking에서 u-Bump 및 Pad 형성 및 Hybrid Bonding에서 Cu Connection 정확도 중요  
→ Overlay System을 통한 Connection 정도 확인 및 Linear Correction



패드 공정 특화 알고리즘 개발로  
다양한 Size의 Pattern 계측 가능

실시간 AF 동작으로  
Wafer Variation 대응 가능

#### ◆ Measurable Application

- PAD Overlay
- Key Overlay
- BAK Overlay
- CD

Global MI 전문 기업으로 거듭나기 위한 Advanced Packaging MI 라인업 구축



## 7. R&D 완료 후 고객 진입 (Warpage\_Back End)



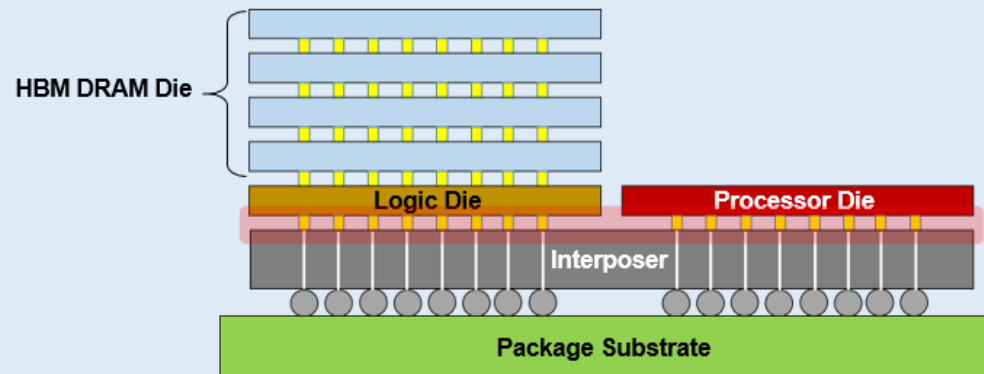
### Wafer Level Packaging 공정에서의 Warpage 계측 장비

WLP 공정 내 Warpage 계측 수요 증가로 제품 공급 확대



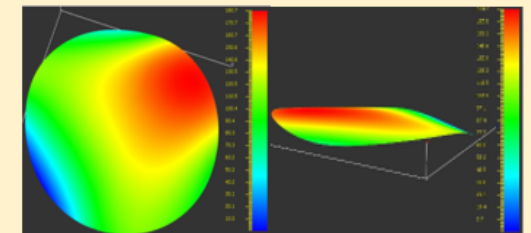
Warpage 계측 장비  
WaPIS-30

Wafer Level Packaging에서 고온의 Molding 진행 후 시료 재질에 따른 Wafer Warpage 검사 필요  
→ High-THP 3D Inspection으로 Carrier와의 부분별 접촉 불량 상태 사전 확인



한 번의 캡처로 Wafer Warpage 측정  
High Throughput 이점으로 경쟁력 확보

◆ Warpage 3D Measurement Result



Global MI 전문 기업으로 거듭나기 위한 Advanced Packaging MI 라인업 구축

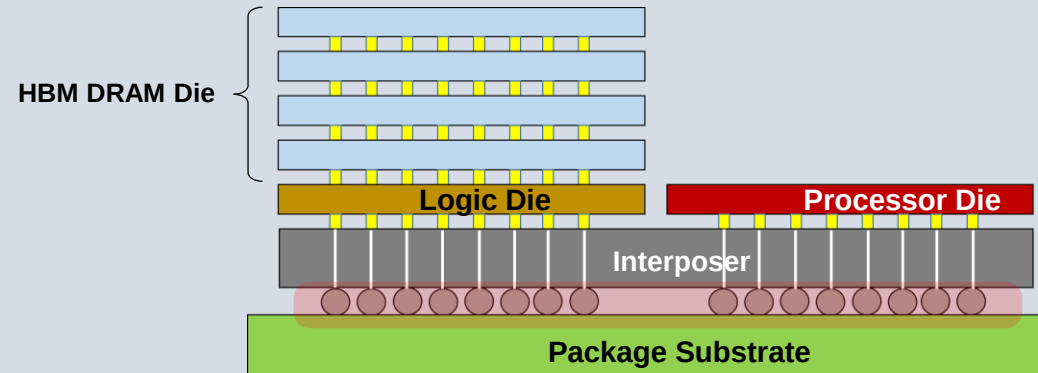
### Package Substrate Bump 계측 장비

차세대 기판 Glass Substrate 시장 선도 2D&3D MI 솔루션 제공

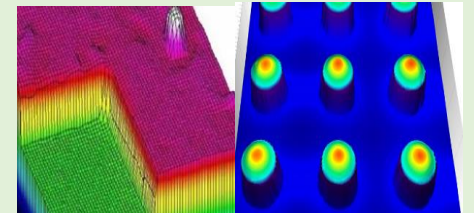


2D&3D Bump 계측 장비  
METIS (PS0253)

Bump는 칩-기판 전기적 연결의 핵심 구조로 수천~수십만 개의 Bump 정밀 계측 필요  
→ WLI (White Light Scanning Interferometry) 방식 높은 정확도, 측정 오차 최소화



- *Large Area Scanning* 측정 방식으로 대면적 검사 수행
- GPU 기반 대용량 data 고속 처리



Global MI 전문 기업으로 거듭나기 위한 Advanced Packaging MI 라인업 구축



**THANK YOU. Q&A.**